

[6] Meese I. M. — Phys. Rev., 1974, v. B9, N 10, p. 4373—4377.

[7] Arimura I., MacKay J. W. — In: Proc. Santa Fe Conf. Rad. Eff. Semicond. N. Y., 1968, p. 204—209.

[8] MacKay J. W., Klontz E. E. — In: Rad. Eff. Semicond. London—N. Y.—Paris, 1971, p. 41—50.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Получено 14.07.1987
Принято к печати 23.10.1987

ФТП, том 22, вып. 4, 1988

МОДЕЛЬ КИНЕТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАСТЕЙ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЯ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ С УЧЕТОМ ДЕФОРМАЦИЙ

Артемьев В. А., Михнович В. В., Титаренко С. Г.

Количественному анализу кинетики формирования областей разупорядочения (ОР), вводимых в полупроводники облучением тяжелыми частицами, посвящен ряд работ [1—3]. В них показано, что кинетика формирования и электрофизические свойства уже сформировавшихся ОР в значительной мере определяются электростатическим потенциалом, обусловленным зарядом на дефектах в ОР (в частности, влияние поля на кинетику формирования объясняется дрейфом подвижных компонентов пар Френкеля — вакансий и междуузельных атомов). Известно, однако, [4, 5], что ОР создают в кристалле заметную деформацию. При наличии деформации возникает дополнительный дрейф (к дрейфу, обусловленному электростатическим полем [1—3]) вакансий (V) и междуузельных атомов (I), что сказывается на кинетике формирования ОР. Далее, так как в неоднородно деформированном кристалле возникает поляризация, пропорциональная градиенту деформации [6, 7] (флексоэлектрический эффект), то создается дополнительный потенциал (к потенциальному, обусловленному зарядом на дефектах в ОР),¹ который влияет и на дрейф V и I , и на значение потенциала сформировавшейся ОР.

В данной работе предложена количественная модель кинетики формирования ОР в полупроводниках с учетом электростатического взаимодействия между дефектами и деформаций, вводимой точечными дефектами в ОР (деформация возникает из-за различия в ковалентных радиусах дефектов и атомов матрицы). На примере кремния (наиболее изученного в смысле дефектного состава полупроводника) проиллюстрировано существенное влияние деформации на свойства ОР.

Пусть в начальный момент времени (после завершения атом-атомных столкновений) $t = 0$ создано скопление подвижных вакансий и междуузельных атомов. С учетом их дрейфа и диффузии, а также реакций V и I между собой и с атомами примесей процесс формирования ОР описывается следующей системой уравнений (рассматривается сферически симметричная ОР, кристалл предполагается изотропным):

$$\frac{\partial N_V}{\partial t} = -\operatorname{div} j_V - 2\alpha N_V^2 - \beta N_V N_I - \gamma_V N_V, \quad (1)$$

$$\frac{\partial N_I}{\partial t} = -\operatorname{div} j_I - \beta N_I N_V - \gamma_I N_I, \quad (2)$$

¹ Здесь не рассматриваются пьезополупроводники. В противном случае необходимо учитывать также электростатическое поле, возникающее вследствие пьезо-эффекта.

$$\begin{aligned} j_{I,V} &= -D_{I,V} \nabla N_{I,V} - \frac{D_{I,V}}{kT} N_{I,V} (L_{I,V} \nabla \varphi - \Omega_{I,V} \nabla P), \\ \frac{\partial N_{I,V}}{\partial r} \Big|_{r=0} &= 0, \quad N_{I,V}(r=\infty, t) = 0, \quad N_{I,V}(r, t=0) = N_{I,V}^0, \\ \Delta\varphi &= -\frac{4\pi}{e} \left\{ \rho(\varphi) - \left(\frac{G_1 + 2G_2}{\lambda + 2G} \right) K \sum_i \Omega_i \Delta N_i \right\}, \quad (3) \\ \frac{\partial \varphi}{\partial r} \Big|_{r=0, \infty} &= 0. \end{aligned}$$

Второе слагаемое в правой части уравнения (3) учитывает поляризацию, пропорциональную градиенту деформации (флексоэлектрический эффект); $N_{I,V}$, $D_{I,V}$, $L_{I,V}$ — концентрация, коэффициент диффузии, средний заряд I и V ; φ — электростатический потенциал ОР; ρ — плотность заряда, локализованного на дефектах, легирующих примесях и свободных носителях; P — среднее гидростатическое давление; Ω_i , N_i — интенсивность и концентрация i -го центра дилатации (сюда входят все дефекты, создающие деформацию); $G_{1,2} \approx e/a$ — флексоэлектрические модули; e — заряд электрона ($e < 0$); a — межатомное расстояние; λ , G — упругие модули; K^{-1} — коэффициент всестороннего сжатия; α , β — скорости формирования дивакансий и аннигиляции I и V ; $\gamma_{V,I}$ — время жизни V и I , обусловленное их захватом легирующими примесями;

$$\begin{aligned} D_{I,V}(r, t) &= \sum_j D_j^{I,V} f_j^{I,V}(r, t), \quad D_j^{I,V} = \pi a^{*2} v e^{-E_j^{I,V}/kT}, \\ L_{I,V}(r, t) &= e \sum_j j f_j^{I,V}(r, t). \end{aligned}$$

Здесь $f_j^{V,I}$ — вероятность того, что в момент времени t на расстоянии r от центра ОР вакансия, междоузельный атом находится в j -м зарядовом состоянии (определяется по известным соотношениям [8]); $E_j^{I,V}$ — энергия активации миграции I и V в j -м зарядовом состоянии; a^* — постоянная решетки; v — частотный фактор; $\gamma_{V,I} = \sum_m \gamma_m^{V,I} N_m^{V,I}$, $\gamma_m^{V,I}$ — скорость реакции взаимодействия V и I с легирующей примесью m -типа концентрации $N_m^{V,I}$. Выражение для среднего гидростатического давления получим, используя уравнение равновесия упругого изотропного тела [9] и учитывая, что деформация возникает из-за различия в ковалентных радиусах дефектов и атомов матрицы,

$$P(r, t) = -\frac{K(1+\sigma)}{3(1-\sigma)} \sum_i \Omega_i N_i, \quad \Omega_i = \frac{\Delta V_i}{V n_a},$$

где ΔV_i — изменение объема на один дефект i -го типа, V — объем атома матрицы, σ — коэффициент Пуассона. Систему уравнений (1)–(3) необходимо дополнить уравнениями, описывающими кинетику формирования стабильных радиационных дефектов — дивакансий (W), комплексов вакансия (междоузельный атом) + атом легирующей примеси типа m :

$$\begin{aligned} \frac{dN_W}{dt} &= \alpha N_V^2, \quad \frac{dN_m^{V,I}}{dt} = \gamma_m^{V,I} N_m^{V,I} N_{I,V}, \quad (4) \\ N_W(r, t=0) &= N_m^{V,I}(r, t=0) = 0. \end{aligned}$$

Здесь N_W — концентрации дивакансий, $N_m^{V,I}$ — концентрация комплексов I (V) + + атом легирующей примеси типа m .

Количественный анализ ² кинетики формирования ОР проводился для кремния. Рассматривался случай облучения реакторными нейтронами. Тогда полное число V и I после завершения каскада атом-атомных столкновений ($t=0$)

² Уравнения (1)–(3) линеаризовались методом Ньютона—Канторовича, разностная схема получена интегро-интерполяционным методом [10] и реализована методом прогонки.

равно 300 [11], а размер вакансионного скопления $l_V \simeq 10^{-6}$ см [12]. Относительно начального размера междуузельного скопления l_I существует неоднозначность: после завершения каскада $l_I \simeq 10^{-6}$ см [12], однако на стадии остывания каскада возможно фоновое увеличение междуузельных атомов, и в результате, как показывают оценки [13], $l_I \simeq 2 \cdot 10^{-6}$ см. Здесь анализируются два случая: $l_I \simeq 10^{-6}$ и $l_I \simeq 2 \cdot 10^{-6}$ см. На рис. 1 представлены расчетные профили концентрации вакансий после завершения междуузельной стадии формирования ОР и дивакансий в окончательно сформировавшейся ОР (n -Si с удельным сопротивлением 100 Ом·см, $l_I \simeq 10^{-6}$ см, температура кристалла $T = 300$ К) с учетом и без учета дрейфа I в поле деформации.

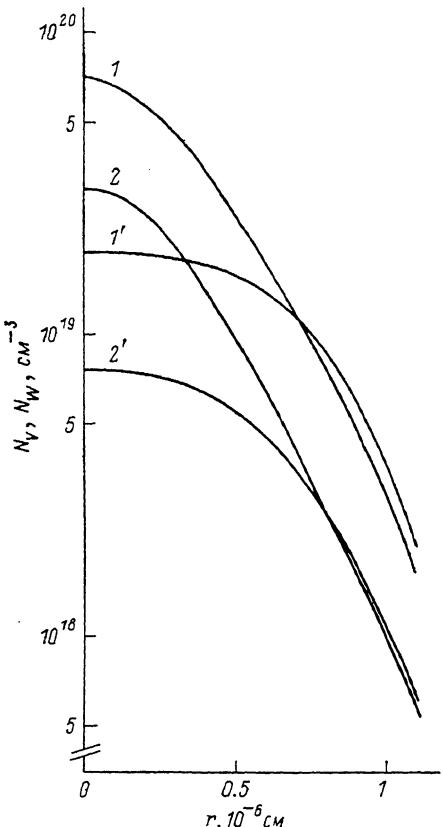


Рис. 1. Профили концентрации вакансий (1, 1') после завершения междуузельной стадии формирования ОР и дивакансий (2, 2') в сформировавшейся ОР с учетом (1, 2) и без учета (1', 2') дрейфа компонентов пар Френкеля в поле деформации.

На рис. 2 представлены расчетные профили потенциала, обусловленного зарядом на дефектах, φ_p и флексоэлектрического потенциала φ_f ($l_I \simeq 2 \cdot 10^{-6}$ см) в окончательно сформировавшейся ОР. Из расчетов следует, что дрейф в поле деформации существенно превосходит дрейф в электростатическом поле (рис. 1), а φ_f сравним с φ_p (рис. 2). Следовательно, в модели кинетики формирования ОР необходимо учитывать влияние деформации.

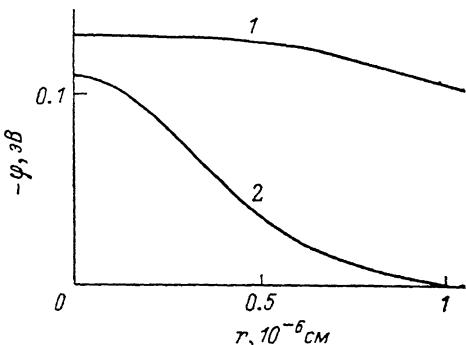


Рис. 2. Профили потенциала, обусловленного зарядом на дефектах в ОР, φ_p (1) и флексоэлектрического потенциала φ_f (2) в сформировавшейся ОР.

В расчетах принимали

$$N_{I, V}(r, t=0) = \frac{A}{(2\pi\delta_{I, V})^{3/2}} \exp\left\{-\frac{r^2}{2\delta_{I, V}}\right\},$$

где A — полное число V и I , при $t=0$ равное 300, $2\sqrt{2\delta_{I, V}} = l_{I, V}$, $\sigma \simeq 0.25$, $\lambda \simeq 0.64 \cdot 10^{11}$ Па, $G \simeq 0.79 \cdot 10^{11}$ Па; $K \simeq 0.98 \cdot 10^{11}$ Па [14]. Скорости реакций рассчитывались из соотношений работы [15]. В качестве примесей рассматривались фосфор, бор, кислород. Для определения гидростатического давления принимали: $r_V^* \simeq 0.95 r_{Si}^*$ [16], $r_W^* = 2r_V^*$, $r_{Si}^* \simeq 1.17$ Å, $r_I^* \simeq 1.5$ Å, r_i^* — ковалентный радиус i -го дефекта. Для V , I , W использовали общепринятую систему зарядовых состояний.

Л и т е р а т у р а

- [1] Винецкий В. Л., Кондрачук А. В. — УФЖ, 1978, т. 23, в. 9, с. 1528—1534.
- [2] Карпик Ю. В., Зинченко В. Ф. — ЖТФ, 1982, т. 52, в. 8, с. 1618—1622.
- [3] Кожевников В. П., Михнович В. В. — ЖТФ, 1983, т. 53, в. 7, с. 1361—1367.

- [4] Ахметов В. Д. — Автореф. канд. дис. Новосибирск, 1984.
- [5] Тимашев Т. П., Уваров Е. Ф. — Электрон. техн., сер. 2, Полупроводн. приборы, 1983, в. 6 (165), с. 9—17.
- [6] Машкевич В. С., Толпиго К. Б. — ЖЭТФ, 1957, т. 32, в. 3, с. 520—525.
- [7] Инденбом В. Л., Логинов Е. Б., Осипов М. А. — Кристаллография, 1981, т. 26, в. 6, с. 1157—1162.
- [8] Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. М., 1977. 672 с.
- [9] Ландау Л. Д., Лишниц Е. М. Теория упругости. М., 1965. 204 с.
- [10] Самарский А. А. Теория разностных схем. М., 1977. 656 с.
- [11] Lindhard J., Mielson V., Scharff M. — Dan. Vid. Selsk. Mat. Fes. Medd., 1963, v. 33, N 10, p. 1—42.
- [12] Акилов Ю. З. — Автореф. канд. дис. Ташкент, 1974.
- [13] Ленченко В. М. — В кн.: Физическая химия в микроэлектронике. Красноярск, 1976, с. 21—29.
- [14] Акустические кристаллы / Под ред. М. П. Шаскольской. М., 1982. 632 с.
- [15] Кожевников В. П., Михнович В. В. — ЖТФ, 1981, т. 51, в. 1, с. 153—157.
- [16] Окулич В. И. Автореф. канд. дис. Горький, 1976.

Получено 12.08.1987
Принято к печати 23.10.1987

ФТП, том 22, вып. 4, 1988

КОНВЕРСИЯ ТИПА ПРОВОДИМОСТИ В СЛОЯХ p -InAs, ОБЛУЧЕННЫХ ИОНАМИ АРГОНА

Герасименко Н. Н., Мясников А. М., Нестеров А. А.,
Ободников В. И., Сафонов Л. Н., Хрящев Г. С.

Имплантация в арсенид индия ионов донорной примеси — серы [1, 2] позволяет создать n -области и изготовить диодные структуры с удовлетворительными электрофизическими и фотоэлектрическими характеристиками. Проявление же акцепторных примесей в легированных ионами слоях InAs затруднено, что связывается с введением при ионной имплантации донорных центров [2, 3]. По-видимому, и в случае легирования ионами серы донорные центры радиационного происхождения могут играть существенную роль и определять относительную простоту изготовления $n-p$ -переходов.

Цель настоящей работы состояла в получении данных о концентрации донорных центров в облученных ионами слоях InAs, в исследовании их температурной стабильности и в оценке возможности создания $n-p$ -переходов за счет донорных свойств радиационных дефектов в InAs.

Арсенид индия p -типа ($p \approx 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ при 77 К), исходно легированный марганцем, облучался ионами Ar^+ с энергией 250 кэВ при комнатной температуре ($\Phi = 10^{13} \div 10^{16} \text{ см}^{-2}$) и $T_{\text{обл}} = 350^\circ\text{C}$ ($\Phi = 10^{14} \div 3 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$). Образцы, облучавшиеся при комнатной температуре, были защищены слоем SiO_2 толщиной ≈ 80 нм, наносимым при температуре синтеза $\approx 200^\circ\text{C}$. При повышенной температуре облучались образцы с открытой поверхностью. Средняя плотность тока пучка во всех случаях не превышала $0.15 \text{ мкA}/\text{см}^2$ для $T_{\text{обл}} = 20^\circ\text{C}$ и $1.5 \text{ мкA}/\text{см}^2$ для $T_{\text{обл}} = 350^\circ\text{C}$. Отжиг образцов, облучавшихся при комнатной температуре, проводился в атмосфере азота под защитным слоем SiO_2 в течение 30 мин. Тип проводимости и слоевая концентрация носителей заряда (n_s) при 77 К определялись по методу Ван-дер-По.

Измерения показали, что сразу после имплантации во всех случаях облученные слои имели проводимость n -типа. Дозовая зависимость слоевой концентрации в исследованном интервале доз очень слабая. Так, для образцов, облученных при комнатной температуре, n_s меняется от $\approx 4 \cdot 10^{14}$ до $\approx 10^{15} \text{ см}^{-2}$ при изменении дозы на 3 порядка — от 10^{13} до 10^{16} см^{-2} . На рис. 1 приведена зависимость слоевой концентрации электронов от температуры отжига для $\Phi =$